

壁紙施工要領書
- スポンジエース LP -

■ 特長

- ・ スポンジエース LP は、吸音効果を持たせるためピンホール加工を施しています。バックキ
ングは布裏（メリヤス地）です。

■ 下地調整

- ①石膏ボード、ベニヤ合板下地の場合
 - ・ 石膏ボードおよび合板の継目部分をパテ処理し平滑にしてください。
 - ・ 釘の頭が出ている場合は、下地面より沈めるよう金槌等で打ち込みます。
- ②モルタル下地の場合
 - ・ モルタル表面に付着している砂、ホコリ等を取り除き、シーラーで下地調整をして乾燥
させてください。

■ 接着剤

- ・ 接着剤は、でん粉系の接着剤にエチレン酢ビ系ボンド（ヤヨイ化学工業製「プラゾール
SS」等）を（石膏ボード、ベニヤ合板で約30%、モルタルで約40～50%）混合し、
糊：水＝10：6～7 程度を目安にしてください。（水分の多い薄い糊の場合、壁紙が糊自
体を吸い込んでしまい、接着力が低下します。）
※商品自体にピンホール加工を施しておりますので、商品裏面に接着剤を塗布すると、
表面に染み出る場合があります。

■ オープンタイム

- ・ 接着剤を下地側に塗布する向こう糊施工になります。下地側へは均一に塗布してくださ
い。

■施工

- ・腰が強く自重のある商品ですので、癖がつかず出入隅の納めにやや難点があります。納まりが悪い場合、捨て糊等での対応が有効です。(下地によっては四方回りを生ボンドで納めることも有効です)
- ・ジョイントは重ね裁ち(ダブルカット)にて納めるようにしてください。(石膏ボード等の下地の場合、下地面まで切りつけないようにしてください。)突き付けでの糊のはみ出しを防止します。
- ・エア抜きの際、強くなで付け過ぎると、表面の穴から接着剤が染み出し変色する場合がありますので注意してください。

■その他

- ・厚み(1.0mm)がありますので、下地の不陸は比較的拾いにくい商品です。